

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

573

ML8

Erstellt:

Landwehr, Melanie

Kunde:

Datum:

17.12.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	85		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
B-RS-FR4-ML-0.15mm-070+070-TG150-HF	50200979	70	L2	4 A01
		150		
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
B-RS-FR4-ML-0.15mm-070+070-TG150-HF	50200979	70	L4	7 A02
		150		
		70	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
B-RS-FR4-ML-0.15mm-070+070-TG150-HF	50200979	70	L6	10 A03
		150		
		70	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	85		11
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	0		12
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	13

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1430 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik